

### 3. 室温試験によるウイスカ評価試験

2015年12月21日  
株式会社 オサダ



#### 1. 供試品

##### (1)プリント基板用端子台(各 6 個)

OP-930、OP-910、OP-1100、OP-1500、OTB-620-B-5P、OTB-121-B-5P、OTB-1100NS-B-6P  
OTB-910-B-5P、OULP-948-B-5P

##### (2)ネジ端子(各 6 個)

OT-017、OP-476-1、OT-009-M3-14.1、OT-016-M5、OT-048、OT-048

##### (3)三価クロメート結線ビス(10 個)

#### 2. 試験期間

2014年11月20日～2015年2月12日

#### 3. 試験基準

IEC 60068-2-82:2007 (JIS C 60068-2-82:2009)

#### 4. 試験条件

・試験温度・湿度・時間

温度:30℃ 湿度:60%RH 時間:4000H

#### 5. ウイスカ測定

##### (1)測定器

オリンパス株式会社 DSX 100 マイクロスコープ

##### (2)測定倍率

108 倍

#### 6. 測定結果

##### (1)プリント基板用端子台・ネジ端子

40  $\mu$  m 以下

##### (2)三価クロメート結線ビス

20  $\mu$  m 以下

以上